(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2003 年11 月20 日 (20.11.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/095579 A1

(51) 国際特許分類[7]: C09J 11/00, 201/00, 5/00, 7/00, H01L 21/304, 21/301

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/05899

(22) 国際出願日: 2003 年5 月12 日 (12.05.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-136995	2002 年5 月13 日 (13.05.2002)	JP
特願2002-157059	2002 年5 月30 日 (30.05.2002)	JP
特願2002-157060	2002 年5 月30 日 (30.05.2002)	JP
特願2002-235607	2002 年8 月13 日 (13.08.2002)	JP
特願2002-282307	2002 年9 月27 日 (27.09.2002)	JP
特願2003-59542	2003 年3 月6 日 (06.03.2003)	JP
特願2003-61792	2003 年3 月7 日 (07.03.2003)	JP
特願2003-61793	2003 年3 月7 日 (07.03.2003)	JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ジェイエスアール株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒104-0045 東京都 中央区 築地五丁目6番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 横山 泰明 (YOKOYAMA,Yasuaki) [JP/JP]; 〒104-0045 東京都 中央区 築地五丁目6番10号 ジェイエスアール株式会社内 Tokyo (JP). 別所 信夫 (BESSHO,Nobuo) [JP/JP]; 〒104-0045 東京都 中央区 築地五丁目6番10号 ジェイエスアール株式会社内 Tokyo (JP). 花村 政暁 (HANAMURA,Masaaki) [JP/JP]; 〒104-0045 東京都 中央区 築地五丁目6番10号 ジェイエスアール株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大島 正孝 (OHSHIMA,Masataka); 〒160-0004 東京都 新宿区 四谷四丁目３番地 福屋ビル 大島特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

WO 03/095579 A1

(54) **Title:** COMPOSITION AND METHOD FOR TEMPORARILY FIXING SOLID

(54) 発明の名称: 固体の一時的固定のための組成物および方法

(57) **Abstract:** A method for firmly fixing two solids mutually and temporarily. The method is a temporary fixing method for mutually and temporarily fixing two solids by a liquid crystal compound or a composition containing the same. This method is a temporary fixing method for a chemical machine polishing pad, wherein when, for example, a solid is used as a chemical machine polishing pad for semiconductor device wafers and another solid is used as a surface plate for fixing it thereon, a semiconductor device wafer is fixed thereon and polished.

(57) 要約: 2つの固体を相互に且つ一時的に堅固に固定する方法である。その方法は、2つの固体を、液晶化合物またはそれを含む組成物により、相互に且つ一時的に固定する一時的固定法である。この方法は、例えば1つの固体を半導体デバイス用ウエハの化学機械研磨用パッドとし、もう1つの固体をそれを固定するための定盤としたとき、半導体デバイス用ウエハをその上に固定して研磨するための、化学機械研磨用パッドの一時的固定法として用いられる。